

广东德瓷技术有限公司

Dc-piezo Technology Co.,LTD.

产 品 规 格 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Tel:0755-8327 8880

E-mail : 13798552005@qq.com

Fax:0755-8327 9488

Website : www.dc-piezo.com

客户名称 (CustomerName) :					
产品名称 (Product Name) :			压电陶瓷晶片		
产品型号 (Product Type) :			DCCP-P4-Φ50*3		
制订日期 (Dateprepared) :					
供应商确认 Paizhou Approv			客户确认 Customer's Approval		
制 订 (签章)	核 准 (签章)	业 务 部 (签章)	确 认 人 (签章)	核 准 (签章)	采 购 部 (签章)

广东德瓷技术：深圳市坪山区马峦街道沙坐社区沙宝路 6 号厂房

1 主题内容和适用范围 Subject and Scope

1.1 主题内容 Subject

本规格书规定了压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ50*3 的技术要求和包装规范.

This specification provides the technical requirements, and packaging specifications for piezoelectric ceramic ring DCCP-P4-Φ50*3

1.2 适用范围 Sphere of Application

本规格书适用于压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ50*3 最终交付要求的描述.

The specification specified the applications on final delivery requirements of the piezoelectric ceramic product DCCP-P4-Φ50*3. After customers recognize this specification is the basis for test of these products.

2 产品型号 Product Model

DCCP-P4-Φ50*2.6

3 命名规则 Naming Rules

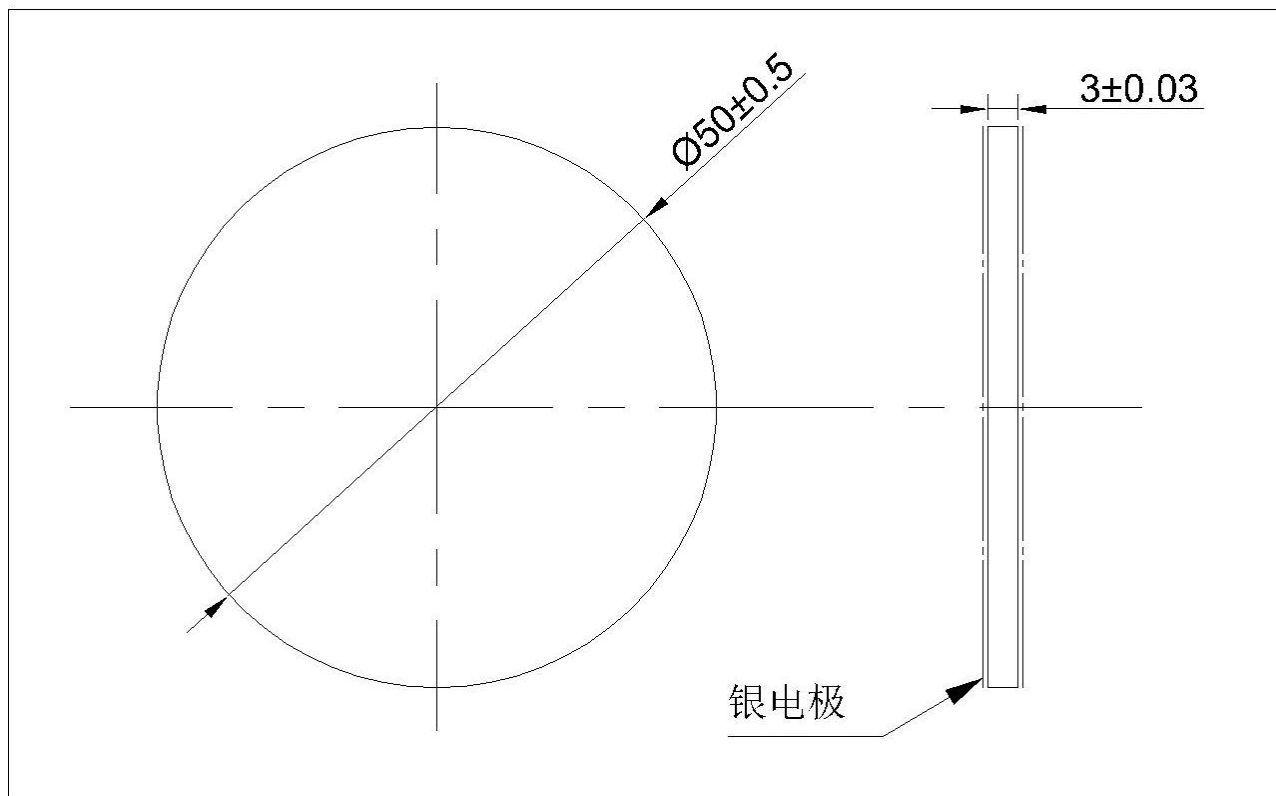
型号 Model: DC C P - P4 - Φ 50*3 - S - 1

① ② ③ ④
⑤
⑥ ⑦

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| ① 德瓷技术代码 | Deci Code |
| ② C:晶片; A:雾化片 | C: Ceramic Chip; A: Atomizer plate |
| ③ P:平板片; H 中孔片 | P: Plate; H: Hole |
| ④ 材料名称 | Material name |
| ⑤ 尺寸 | Dimensions |
| ⑥ 电极形状代码 | Electrode shape code |
| ⑦ 电极特征代码 | Protective layer code |

4 外观要求 Appearance Requirements

4.1 外形尺寸(mm) Dimension



4.2 外观要求

银层

电极面上无明显露瓷、磨伤及划伤；电极边缘不发黄；电极正负极标注正确

瓷体

无裂纹，无明显缺瓷、崩边等损伤

Silver layer

no exposure of porcelain, grinding hurt or scratch on electrode surface

Porcelain body

no cracks, intact porcelain, chipping and other damage

5 性能参数 Performance Parameters

编号	参数	符号	单位	技术要求
1	机电耦合系数	K_p	%	$\geq 53\%$
2	介电损耗	$\tan \delta$	%	$\leq 0.5\%$
3	静态容量	C	pF	$7800 \pm 10\%$ (可按客户要求分档)
4*	居里温度	T_c	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 300^{\circ}\text{C}$
5*	机械品质因素	Q_m	--	≥ 500
6*	密度	ρ	kg/m^3	7.45×10^3
7*	频率常数	N	Hz. m	$2200 \pm 5\%$

注：1. 测试温度为 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$

2. 表中编号 1-3 为晶片性能参数，4-7 为材料性能参数；

3. 建议焊接温度不超过 350°C ，时间不超过 3 秒；

4. 储存温度 $-25 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，晶片表面发黄可用橡皮擦拭即可去除，不影响其性能。